

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

543

ML6

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

24.09.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	μm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	150		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
C-RS-FR4-ML-0.71mm-070+070-TG150-HF	50200813	70	L2	4
		710		
		70	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	160		5
		0		
C-RS-FR4-ML-0.71mm-070+070-TG150-HF	50200813	70	L4	7
		710		
		70	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	150		8
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		9
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	10

B00

Dicke nach Verpressen

B00:

2290 μm

Tol+:

240 μm

Tol-:

240 μm

Dmax:

2530 μm

Dmin:

2050 μm

Gesamtdicke über alles

0 μm

Tol+:

0 μm

Tol-:

0 μm

Dmax:

0 μm

Dmin:

0 μm

Kundenforderung

Dicke (D):

2400 μm

Tol+:

240 μm

Tol-:

240 μm

Dmax:

2640 μm

Dmin:

2160 μm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

2230 μm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik